

证券代码：688183

证券简称：生益电子

生益电子股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-004

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他</div>              |
| 参与单位名称或<br>人员姓名   | <p>广发基金、国金证券、Thaiford Asia、华创证券、富国基金、浙商资管、中银国际、华福证券、中信建投、永赢基金、外贸信托、洲和资本、景林资产、东方阿尔法基金、visionpoint、国投瑞银基金、建信理财、Millennium、领仁投资、东亚前海证券、中邮证券、诺安基金、东方基金、融通基金、泉果基金、同犇投资、西南证券、盘京投资、华夏基金、歌汝投资、山西证券、国海电子、东方财富、国联民生证券、鲲鹏投资、中信证券、创华投资、深圳财沣投资、深圳创富兆业基金</p> <p>本次投资者关系活动采取现场会议形式，现场调研机构均签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>            |
| 时间                | 2026年9月3日、2026年9月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 地点                | 生益电子会议室现场会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 上市公司<br>接待人员      | 董事会秘书：林江<br>财务总监：黄乾初<br>技术副总监：彭刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资者关系活动<br>主要内容介绍 | <p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。</p> <p>二、互动交流的主要问题</p> <p>1、公司2026年上半年业绩情况</p> <p>2026年上半年，公司紧抓行业高景气机遇，秉持“市场引领、双轮驱动”的经营理念，锚定中高端赛道持续深耕。在巩固前期市场拓展成果的基础上，加快产能释放、深化技术升级、强化质量管控，经营业绩实现较快增长，高端产品收入占比稳步提升，核心竞争力持续提升。2026年上半年公司实现营业收入 57.84 亿元，同比增长 53.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 11.11 亿元，同比增长 109.36%；综合毛利率 34.31%，同比提升 3.92 个百分点。</p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>2、公司产品结构情况</b></p> <p>随着公司不断完善产品布局,持续推进“抓住机会,实现市场覆盖新突破”的市场战略,2026年上半年公司产品主要分为服务器/计算机板、通信网络设备板、汽车电子板以及其他板(包括消费电子、医疗、航空航天等)等,其中服务器/计算机板收入占比为59.14%,通信网络设备板占比为29.54%,汽车电子板以及其他板收入占比为11.32%。</p> <p><b>3、公司2025年向特定对象发行A股股票募投项目情况和进度</b></p> <p>东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目属于公司现有产品的升级迭代和产能扩张,该项目主要生产5阶及以上高阶HDI板(含mSAP工艺HDI产品),达产后年产能将达到16.72万平方米。项目已完成厂房土建工程设计、审图和招标等工作,并于2026年5月底进入土建工程基础施工阶段,计划2028年试生产。公司将加快项目建设,以满足日益增长的高端市场需求。</p> <p>吉安智能制造高多层算力电路板项目计划年产能70万平方米,规划产品以平均16层的高多层板为主,项目实施地点为现有厂房的四层、五层全部区域和一层已分隔的独立区域,目前公司已使用自有资金进行前期的建设,项目第一阶段在2026年6月实现全流程贯通试生产,助力公司中高端产能扩充;同时,公司已提前启动项目第二阶段建设工作,力争提前至2026年底前投入试生产,为公司抢抓高端市场、持续优化产品结构提供支持。</p> <p><b>4、公司对未来PCB市场规模以及行业发展前景的预期</b></p> <p>PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,也是电子信息技术的核心基础组件。根据Prismark2026年一季度报告数据,2030年全球PCB产值将增长至1,446.10亿美元,2025年至2030年全球PCB产值的预计年复合增长率达11.0%。其中,服务器/数据存储和通信网络是增速最快的细分市场,且服务器/数据存储已经超越消费电子成为PCB下游第一大应用领域。</p> <p>其中受益于全球AI基础设施(包含服务器设备、存储设备、AI加速卡等)市场规模正快速扩张,由此带动的AI服务器等高算力设备出货量迅速提高。根据Prismark数据,预计2029年全球服务器/数据存储领域PCB产值规模将达到225.46亿美元,2024年-2029年将以15.6%的复合增长领跑PCB其他应用领域。</p> <p>AI数据中心的快速扩张亦相应带动高端交换机和高速光模块等高速网络基础设施的需求增长,根据Prismark数据,预计到2029年,全球通信设备领域PCB产值将达到151.55亿美元,2024-2029年将保持平均每年</p> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>10.2%的复合增长。</p> <p>未来公司对PCB行业的发展保持信心，将通过深耕服务器和通信网络等市场，紧抓本轮行业高景气机遇。</p> <p><b>5、目前原材料价格增长及原材料供应紧张对公司业绩的影响</b></p> <p>2025年第4季度起，受铜价等外部因素以及上游供应商产能受限等影响，原材料价格出现上涨，本轮原材料涨价属于行业共同面对的现状，原材料的涨价将带动产业链各个环节价值传导。同时公司通过持续强化内控管理，进一步优化产品结构及提升质量管理水平，促进了公司业绩增长。2026年上半年，公司毛利率及净利率均实现同比增长。</p> <p>后续公司将持续关注主要原材料以及大宗商品等的价格走势，及时分析市场供需变化，并根据订单情况、库存情况以及原材料和大宗商品价格波动预测，动态调整公司的供应策略，将原材料价格增长对公司业绩影响降低。</p> <p><b>6、公司下游客户开发的情况</b></p> <p>公司秉承“市场引领，双轮驱动”的发展战略，不断与服务器/计算机、通信网络、汽车电子等下游领域知名客户持续积极接触或建立合作关系。目前公司客户储备丰富，且主要客户均为下游行业的头部企业，已涵盖众多境内外头部AI客户，同时公司也持续推进新客户的认证和开发工作，新客户认证进度良好。</p> <p><b>7、公司目前产能及未来产能规划情况</b></p> <p>截至2026年6月末，公司设计现有产能为246万平方米。对于未来的产能扩张，公司目前有多个扩产项目在建，合计在建产能159.21万平方米。除再融资的两个募投项目以外，公司其他扩产项目主要为3个自有资金项目，其中智能算力中心高多层高密互连电路板项目二期按计划推进建设与设备部署，并已于2026年上半年内逐步投入使用；泰国工厂一期（大算力高端电路板）项目目前进入设备安装与调试的关键阶段，全力推进项目2026年第三季度试生产和运行；吉安“芯算智联”高速互联电路板制造项目于2026年8月28日经第四届董事会第五次会议审议通过。</p> <p>公司将根据宏观环境和行业发展情况，特别是AI相关技术和市场需求变化，结合公司实际经营发展需要，持续优化产品规划和产能布局。</p> <p><b>8、公司的技术优势</b></p> <p>公司紧跟国际先进技术的发展趋势，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变化信息，及时掌握客户产品设计和需求的变</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>化，针对新产品、新技术进行前期研究开发。公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业，获得广东省企业技术中心、广东省高端通讯印制电路板工程技术研究开发中心、广东省博士工作站、东莞市高速印制电路板重点实验室等资质，多项成果获得科技成果鉴定国际先进水平或国内领先水平，同时获得了众多印制电路板相关的知识产权，截至2026年06月30日，公司知识产权申请量已达751个，其中发明专利604个，实用新型专利92个，专利PCT国际申请26个，美国发明专利1个，软件著作权28个；知识产权获得量已达410个，其中发明专利306个（含1个美国发明专利）。公司具备完善的研发创新平台，持续多年的研发投入和技术积累，公司已掌握了大尺寸印制电路制造技术、高阶微盲孔制造技术（HDI）、高速信号损耗控制技术、混压技术、N+N双面盲压技术、内置电容技术、散热技术、立体结构PCB制造技术、分级金手指制造技术、高厚径比微通孔制造技术、微通孔局部绝缘技术、内置导电介质热电一体式PCB制作技术、高多层PTFEP加工技术、高多层低损PCB加工技术、1.6T高速光模块PCB制作技术、埋空腔技术、高多层N+M结构PCB制作技术、高多层厚铜技术、内埋平面电阻技术、多界面Z向互联技术、高多层大尺寸刚挠结合板制作技术等多项行业领先的核心技术，使公司持续保持了较强的核心竞争力。</p> <p><b>9、吉安“芯算智联”高速互联电路板制造项目</b></p> <p>为抢抓行业发展机遇，满足市场HDI产品快速增长的需求，进一步深化产能布局和升级产品结构，公司计划由全资子公司吉安生益电子有限公司在现有厂房投资建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目。计划投资总额约为225,700.00万元，其中包括已投入的厂房建设费用，本次新增投资约215,800.00万元。产品定位应用于AI服务器、汽车电子等相关领域的HDI印制线路板，项目将分阶段建设，全部建成后设计产能44.59万平方米/年。该项目建成后，将扩大公司HDI产品产能和公司经营规模，进一步提升公司盈利水平和行业竞争力。</p> <p><b>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</b></p> |
| 附件清单<br>（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 日期           | 2026年9月7日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |